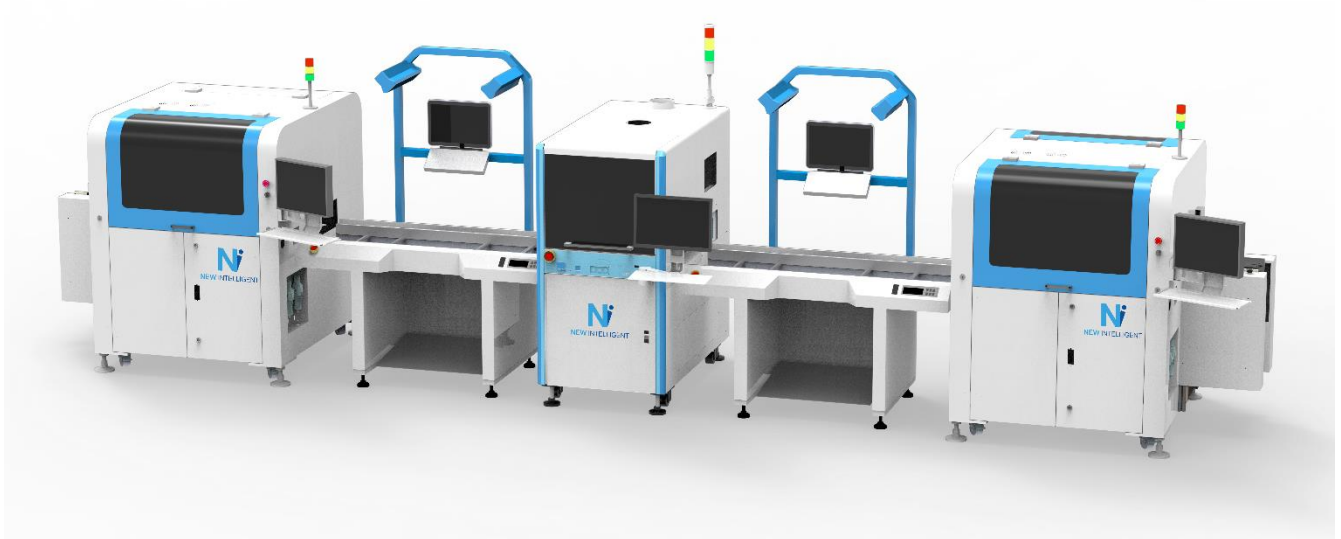


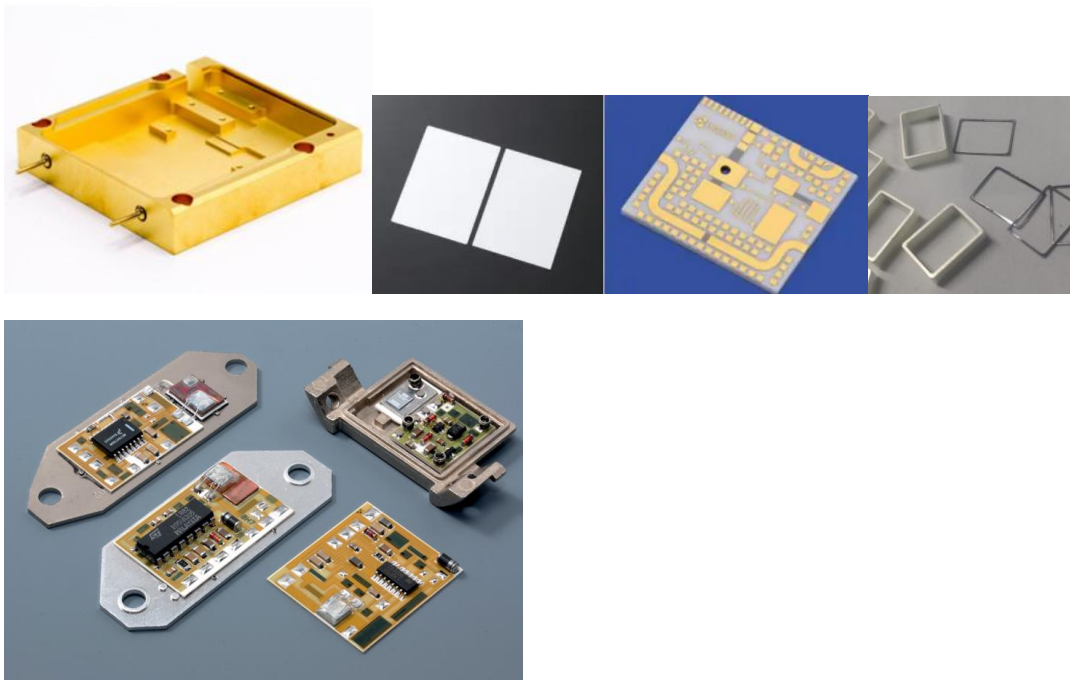
## ● 产线概述及布局

该线设备主要满足中小批量 MCM、TR 等金属封装模块焊接前的自动装配需求，涉及的工艺过程包括：助焊剂喷涂、焊片装配、基板装配、镀金焊盘防护胶点涂、焊膏点涂、金属围框装配、压块装入等工艺过程。上述工艺过程分几个独立设备单元串联成线，设备单元之间，采用 SMEMA 通讯协议，通过轨道进行连接。

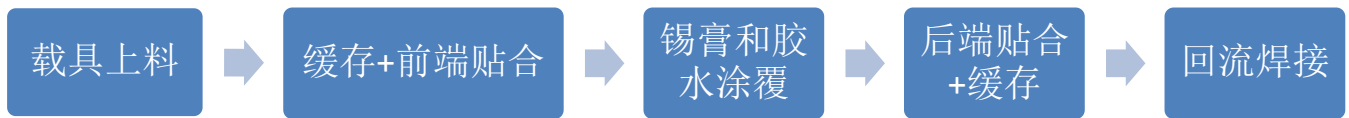


## ● 适合器件

陶瓷片，焊锡片，电阻电容，PCBA，金属屏蔽罩围框，金属封装管壳



## ● 工艺流程



## ● 功能概况

序号	名称	数量	单位	主要功能和特点描述
1	前端贴合机	1	套	缓存上料； 轨道输送； 视觉分拣上料； 矩阵盘上料； 贴装焊锡片，陶瓷片，基板； 助焊剂涂覆； 焊锡膏涂覆
2	输送轨道	1	套	输送
3	高速点胶机	1	套	镀金焊盘防护胶涂覆； 焊锡膏涂覆
4	输送轨道	1	套	输送
5	后端贴合机	1	套	轨道输送； 视觉分拣上料； 矩阵盘上料； Feeder 上料（SMT 卷料）； 贴装围框，屏蔽罩，电阻电容，PCBA； 压块装入； 缓存下料；
6	输送轨道	1	套	检验； 补料； 输送
7	回流炉	1	套	焊接，固化
8	输送轨道	1	套	检验； 输送
9	收板机	1	套	收料